

信昌電子陶瓷股份有限公司

2024年法人說明會

(Stock code: 6173)

報告日期:2024年5月27日

投資人關係聯絡人：發言人 羅夏盈

Email：IR@pdc.com.tw

電話：03-4753355

報告內容

- 公司概述
- 財務績效
- 主要市場展望
- 營業聚焦與機會

公司概述

信昌電陶

- 成立日期 1990年6月
- 資本額 新台幣17.2 億
- 員工人數 700
- 品牌 PDC
- 營業額 2023年 NT\$36.5億
2024 Q1 NT\$8.7 億



營運據點

- 台灣 桃園廠 / 楊梅廠
- 中國 吳江廠/ 東莞辦公室



生產經歷

- MLCC/CR Since 1990 (34 years)
- Powder Since 1995 (29 years)

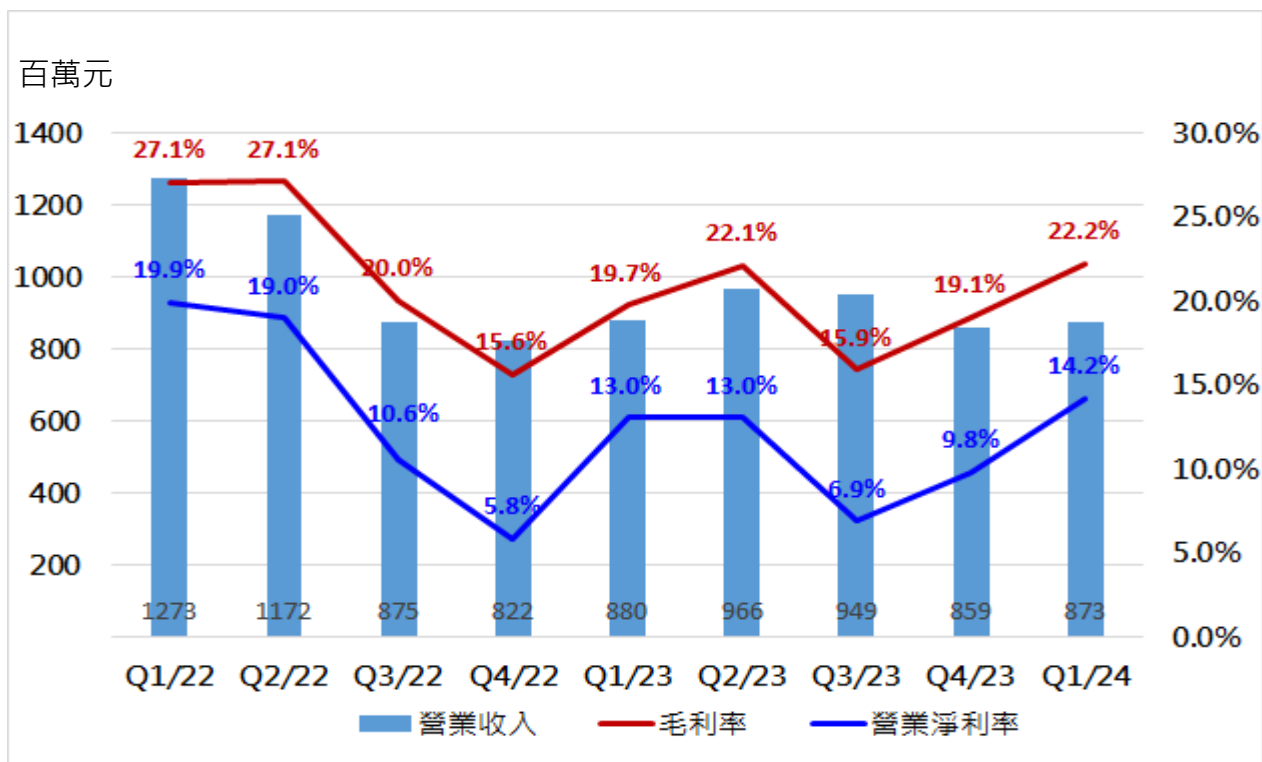


合併綜合損益表比較

單位:台幣百萬元;每股盈餘為元

	2024 第一季	2023 第四季	QoQ	成長(%)	2023 第一季	YoY	成長(%)
營業收入	873	859	14	2%	880	(7)	-1%
營業毛利	194	164	30	18%	174	20	12%
毛利率(%)	22.2%	19.1%	3.2%		19.7%	2.5%	
營業淨利	124	84	39	47%	115	9	8%
營業淨利率(%)	14.2%	9.8%	4.4%		13.0%	1.1%	
稅前淨利	185	53	133	252%	179	6	4%
歸屬本公司業主之稅後淨利	146	41	105	256%	150	(4)	-2%
稅後淨利率(%)	16.7%	4.8%	12.0%		17.0%	-0.3%	
每股盈餘(元)	0.85	0.24	0.61		0.87	(0.02)	

營收/毛利率/營業淨利率趨勢



產品規劃及應用

- 4G基站
- 伺服器
- Modem/Router/STB
- 電源供應器
- 消費電子產品

- AI 整合
- 工業智能
- 5G基地台
- IOT
- 電動車
- 醫療、航太
- 智慧電網

2013

營業收入:NT 2.13B
營業毛利率:15.7%
EPS: 0.11

產品主軸

-元件:工業、網通、消費用高功率MLCC,CHIP-R,Inductor



-材料:Disc,MLCC介電陶瓷粉末



800nm

600nm

2023

NT 3.65B
19.2%
2.64

產品主軸

-元件:工業、網通、車用、醫療、航太用高功率高可靠度MLCC,CHIP-R,Inductor



-材料:Disc,高規格MLCC,LTCC,微波介電陶瓷粉末



400nm

250nm

250nm

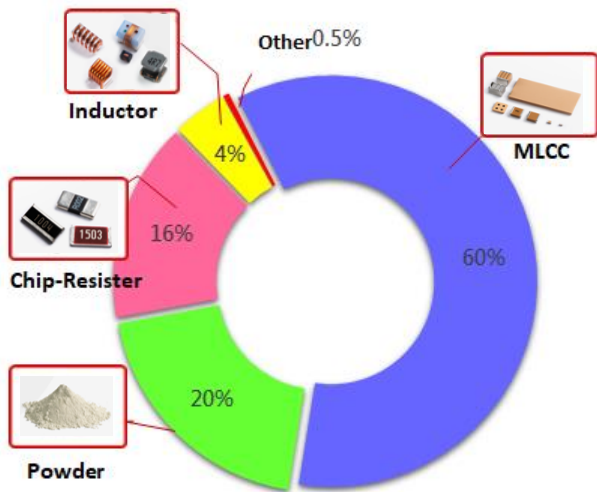
200nm

2024 Q1

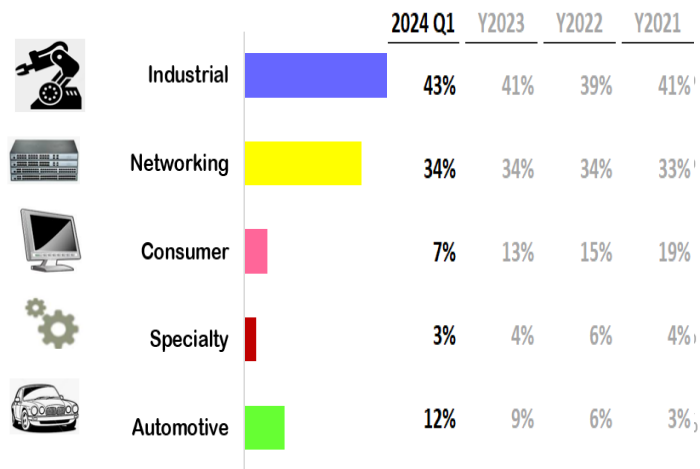
NT 0.87B
22.2%
0.85

2023 營業比重

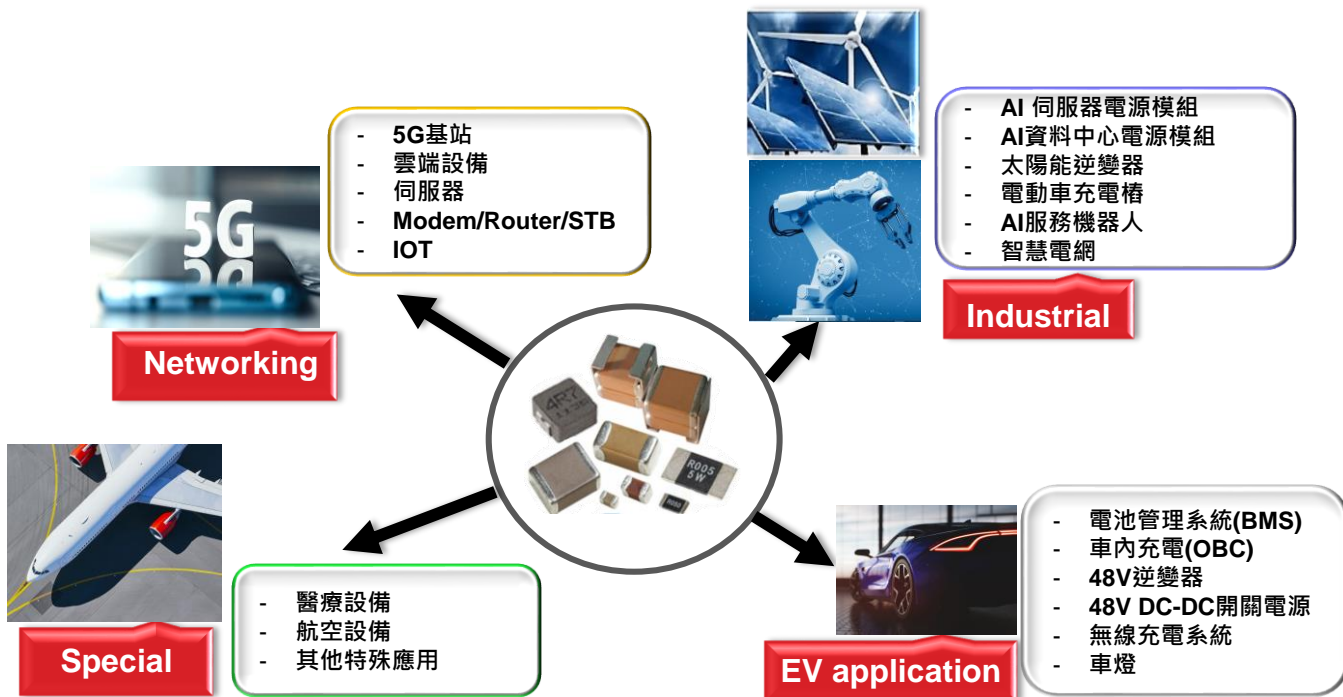
產品比重



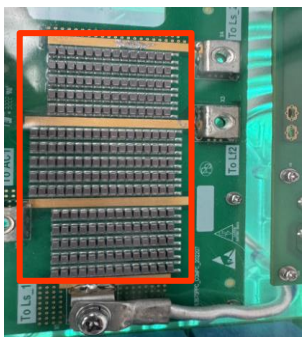
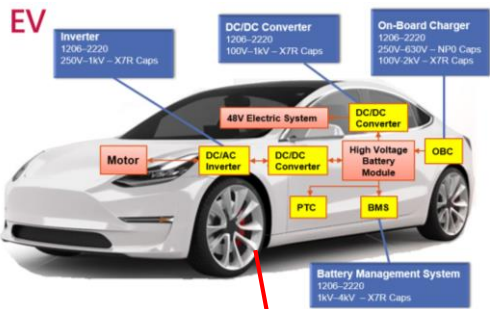
應用比重



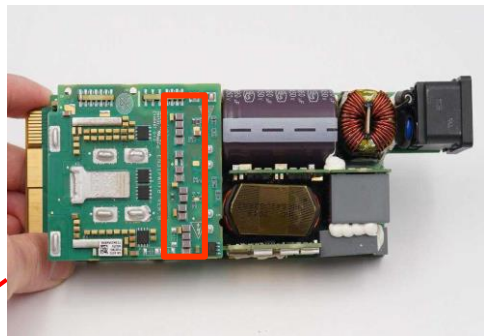
產品主要應用領域



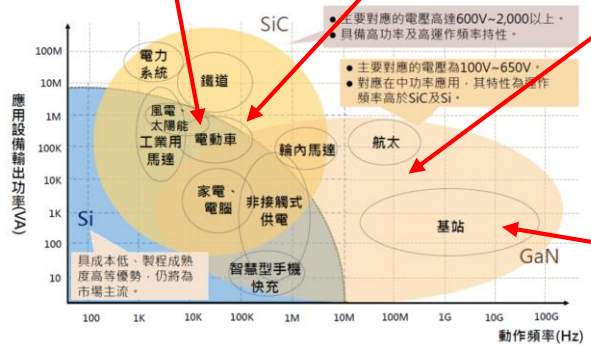
產品主要應用領域



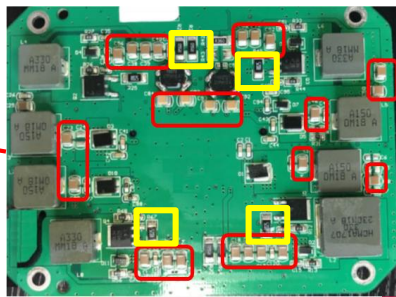
EV Wireless 充電模組



3000W AI電源模組

















資料來源: DIGITIMES Research



小型基站

2024 主要應用市場景氣預估

產業別	應用	2024市場預估	市場預估分析
工業	Power Supply		電源市場規模2023 年達339.6億美元，市場需求預計將小幅上升。
汽車	EV		到 2024 年，全球電動車銷量（包括純電動車 (BEV) 和插電式混合動力車 (PHEV)）將達到 1,800 萬輛。
	充電樁		預計2023年至2028年電動車充電基礎設施市場規模將以30.75%的複合年增長率成長。
PC&P	PC		PC市場將在2024年反彈，較2023年年增3.4%，主要得益於PC更新周期和AI整合。
	NB		隨著長達 2 年的經濟衰退結束，通膨緩解以及新產品推出，NB 市場預計 2024 年將成長 4.7%。
	Server		TrendForce預計2024年整機出貨量較去年同期僅成長2%~3%。
Networking	Datacenter		全球資料中心市場預計 2024 年將成長 13.8%，預計到 2032 年將達到 81.13B 美元左右，2023 年至 2032 年複合年增長率為 14.2%。
AI	AI Server		TrendForce將2022年至2026年AI伺服器年複合成長率預測上調至29%。
行動通訊	Smartphone		智慧型手機市場將在 2024 年繼續復甦，預計將成長 3.8%，5G 採用率到 2024 年將成長 20%，繼續成為亮點。
消費電子	TV		消費者預算受限、中國房地產泡沫和電視面板價格上漲都抑制了電視需求。巴黎奧運和2024年歐洲盃預計將支撐0.2%的小幅成長。
New Life	AR/VR		2024年AR/VR耳機市場復甦，AR/VR耳機出貨量預計成長46.4%。
	Medical Device		預計2024年全球智慧醫療設備市場規模將達190B美元，年增10.4%。
5G 網路	5G O-RAN		預計 2023 年至 2030 年 O-RAN 市場複合年增長率將達到 33.0%。
	5G Base station		預計到2032年，全球5G基地台市場營收將成長468.9B美元，2023年至2032年複合年增長率為29.3%。



Sunny >11%

Partly Sunny 6%~10%

Cloudy 0%~5%

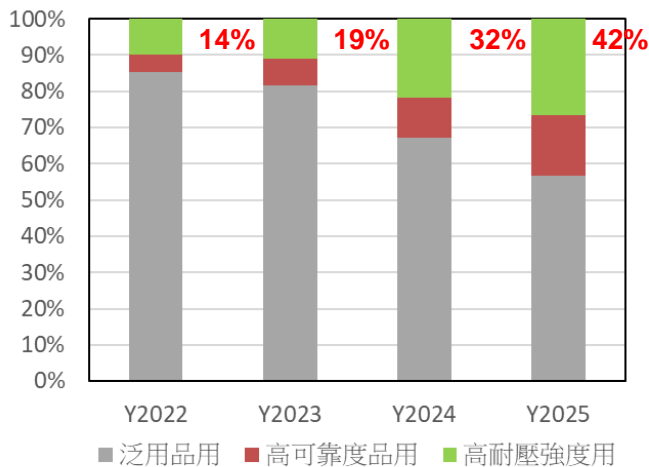
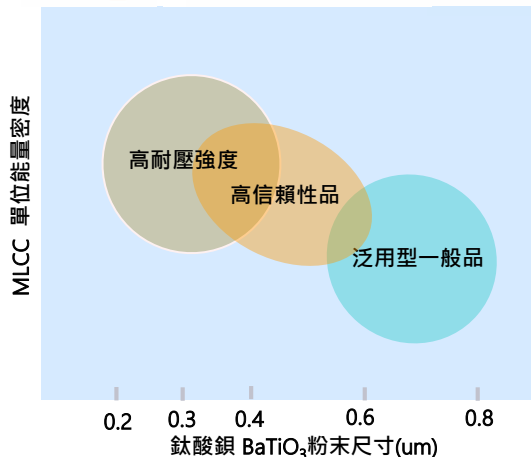
Rainy -1%~5%

Thunderstorm >5%

2024 主要應用市場 vs 信昌產品對應

應用市場	信昌對應產品				
AI Server ,Data center, 5G Base Station,Networking	<p>Mid/Hi-Voltage & High Reliability 1206~2225 100V-6KV</p> <p>10uF → 100uF</p> 	<p>Mega Cap Chip Size 0612 to 1225 PR 1W to 2W</p> <p>航空,醫療,軍用...特殊領域 開發各式堆疊架構</p> 	<p>Safety Certified Cap.(X1/Y2,X2/Y3) 1206~2220 (3000V/5000V)</p> <p>→ 車規+安規 產品開發</p> 	<p>LLC NPO 1206~2220/630V~2,000V) 10nF → 100nF</p> <p>替Film Capacitor</p> 	<p>Low DC BIAS Cap. (X7T) 1210~2220 250V-1KV</p> <p>1uF → 10uF</p> <p>替代鉅電容</p> 
EV, Charging Station	<p>Automotive Certificate Cap.(X7R/NPO) 1206~2220 50V-4KV</p> <p>10uF → 100uF 高容規格開發</p> 	<p>Automotive Certificate Chip-R</p> <p>Wide Terminal Metal strip Anti-Sulfur Triple & High Power Surge Thick film Low TCR</p> 	<p>HV+UL Safety Certification Chip Size 0603 to 2512 VV 200V to 3KV UL/IEC/CQC 62368</p> 	<p>2x/3x High Power CHR Chip Size 0603 to 2512 PR Max 3W</p> 	<p>Anti-Surge CHR Chip Size 0603 to 2512 PR Max 2W</p> 
Medical,Aerospace, Application	<p>ODM (X7R/NPO) Ultra Big size 3035~13060(~10,000V)</p> <p>航空,醫療,軍用...特殊領域 以PME為主</p> 	<p>Mega Cap Chip Size 0612 to 1225 PR 1W to 2W</p> <p>航空,醫療,軍用...特殊領域 開發各式堆疊架構</p> 	<p>ODM (X7R/NPO) Discoidal/Array</p> <p>航空,醫療,軍用...特殊領域 多孔特殊規格之開發</p> 		

PDC MLCC陶瓷粉末持續轉向利基產品應用



機會

- 展望2024,如前述AI Server ,Data center, 5G Base Station, EV, Charging Station為主要市場預估成長較高之領域,PDC大尺寸、高功率MLCC/ Chip-R應用機會增加.
- 特殊應用市場如Medical 、 Aerospace 預估成長 .
- 高可靠度NPO MLCC 取代Film Cap及 X7R,X7T MLCC取代鋁及鈮電解電容機會增加.
- 5G應用之相關射頻元件大量增加，進而帶動LTCC及高頻低介電濾波應用陶瓷粉末需求增加.
- 隨著EV市佔逐漸提高及車用及充電樁相關需求升高，應用於車載及充電設備之陶瓷粉末隨之增加.

營業聚焦

■ MLCC、Chip-R –

- 針對高成長之應用市場領域，持續開發更高功率及高電容量之MLCC及高功率Chip-R.
- 具材料自主開發及製程技術能力，可有效配合中高壓及大尺寸之特殊MLCC導入高附加價值之市場，及降低成本提升競爭力.

■ 介電陶瓷粉末 –

- 持續開發高階、高溫、高壓、高容、及特殊應用MLCC介電陶瓷粉.
- 因應5G與AI應用市場成長需求，持續開發高階及特殊應用微波粉末.
- 持續開發各系列RF/高頻元件用LTCC材料與Cu電極製程MLCC介電陶瓷粉.

Thank you!

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.